

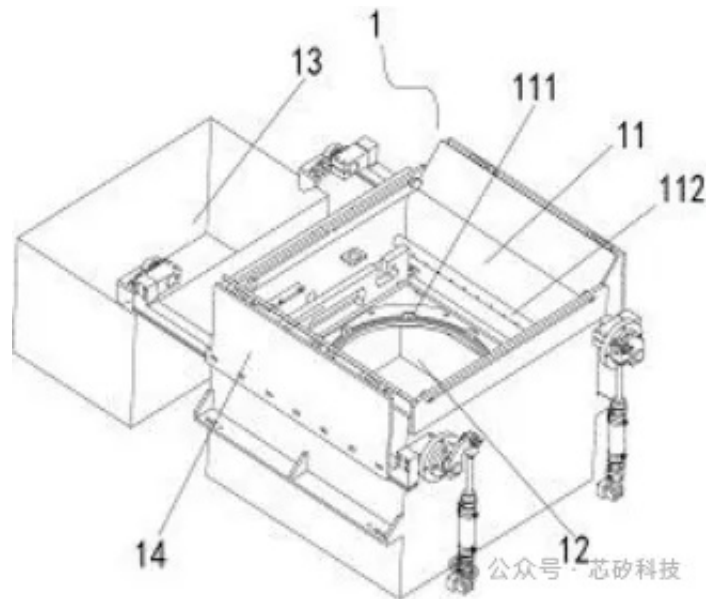
荣获“半导体晶圆清洗装置的清洗方法”专利 技术创新再添新成果！

自豪地宣布，根据国家知识产权局最新公告信息显示，苏州芯矽电子科技有限公司成功获得一项名为“半导体晶圆清洗装置的清洗方法”的发明专利，授权公告号为CN 118321251 B，该专利申请日期为2024年6月。这标志着公司在半导体技术领域的创新实力再次得到权威认可，进一步巩固了我们在行业内的技术领先地位。



专利信息介绍

本次获得的“半导体晶圆清洗装置的清洗方法”专利，是针对当前半导体制造过程中对高效、精准清洁技术的迫切需求而研发的一项创新解决方案。该专利技术通过优化解决现有技术中清洗时微孔内存在气泡而导致无法完成100%微孔的清洗问题。



在全球半导体产业竞争日益激烈的今天，技术创新成为企业持续发展的核心驱动力。此次专利的获得，不仅是对苏州芯矽电子在技术研发上不懈努力的认可，也是对我们持续推动行业技术进步的鼓励。我们相信，这一专利技术的商业化应用将进一步提升公司产品的竞争力，为客户提供更高效、更可靠的半导体制造解决方案，同时也为中国半导体产业的自主可控发展贡献力量。

感谢社会各界长期以来对苏州芯矽电子的关注与支持。我们将以此为契机，不忘初心，砥砺前行，持续为客户创造更大价值，为推动中国乃至全球半导体行业的繁荣发展作出新的更大贡献。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/219027.html>